62mm C-Serien Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material

Eigenschaften



- Elektrische Eigenschaften
  - V_{CES} = 1200 V
  - $I_{C\ nom}$ = 450 A / I_{CRM} = 900 A
  - Trenchstop™ IGBT7
  - V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten
  - Geeignete Infineon Gate-Treiber finden Sie unter https://www.infineon.com/gdfinder
- Mechanische Eigenschaften
  - 4 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
  - Große Luft- und Kriechstrecken
  - Hohe Leistungsdichte
  - Isolierte Bodenplatte
  - Gehäuse mit CTI > 400
  - Standardgehäuse
  - Pre-applied Thermal Interface Material

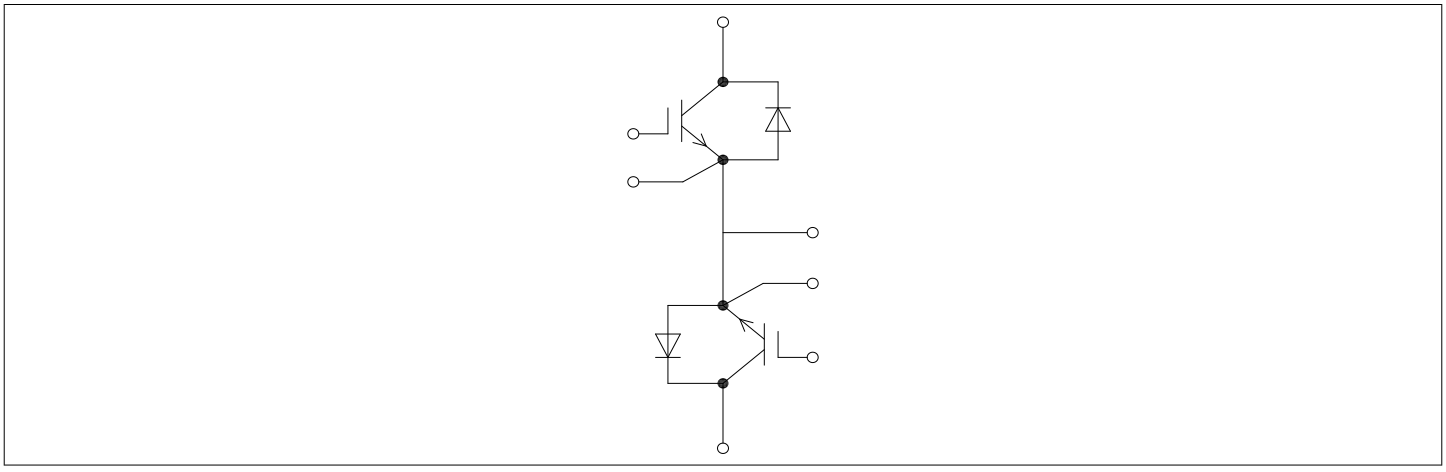
Potenzielle Anwendungen

- Servoumrichter
- Solar Anwendungen
- USV-Systeme
- Motorantriebe
- Hochleistungsumrichter
- Hybrid-Nutzfahrzeuge
- 3-Level-Applikationen

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

Beschreibung 1
Eigenschaften 1
Potenzielle Anwendungen 1
Produktvalidierung 1
Inhalt 2
1 **Gehäuse** 3
2 **IGBT, T1 / T2** 3
3 **Diode, D1 / D2** 5
4 **Kennlinien** 7
5 **Schaltplan** 11
6 **Gehäuseabmessungen** 12
7 **Modul-Label-Code** 13
Änderungshistorie 14
Disclaimer 15

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, t = 60 s	4.0	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	29.0	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	23.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	23.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	11.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 400	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}				20		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, pro Schalter			0.5		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		125	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur	T_{BPmax}					125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	3		6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M6, Schraube	2.5		5	Nm
Gewicht	*G*				340		g

Anmerkung: $T_{vj\ op}$ > 150 °C ist nur im Überlastbetrieb zulässig. Detailierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

2 IGBT, T1 / T2

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1200	V

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 50 °C	450	A
Grenzeffektivstrom der Modul DC-Kontakte	I_{tRMS}		$T_{Terminal}$ = 115 °C, T_C = 90 °C	650	A
			$T_{Terminal}$ = 115 °C, T_C = 115 °C	600	
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		900	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 450 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.50	1.75	V
			T_{vj} = 125 °C		1.65		
			T_{vj} = 150 °C		1.70		
			T_{vj} = 175 °C		1.75		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 9 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V			7.41		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0.7		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			70.8		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.354		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			0.1	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 450 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 0.51 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.370		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.381		
			T_{vj} = 150 °C		0.385		
			T_{vj} = 175 °C		0.389		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 450 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 0.51 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.043		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.049		
			T_{vj} = 150 °C		0.051		
			T_{vj} = 175 °C		0.052		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 450 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.5 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.522		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.588		
			T_{vj} = 150 °C		0.610		
			T_{vj} = 175 °C		0.623		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 450 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.5 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.124		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.263		
			T_{vj} = 150 °C		0.307		
			T_{vj} = 175 °C		0.351		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 450 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 25 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 0.51 Ω, di/dt = 6900 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		14.1		mJ
			T_{vj} = 125 °C		22.2		
			T_{vj} = 150 °C		25		
			T_{vj} = 175 °C		27.7		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 450 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 25 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.5 Ω, dv/dt = 3100 V/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		36.9		mJ
			T_{vj} = 125 °C		58.9		
			T_{vj} = 150 °C		65.6		
			T_{vj} = 175 °C		72.2		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 800 V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt	t_P ≤ 8 µs, T_{vj}=150 °C		1700		A
			t_P ≤ 6 µs, T_{vj}=175 °C		1500		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				0.123	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj\,op}$ > 150 °C is only allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications please refer to AN 2018-14.

3 Diode, D1 / D2

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			450	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		900	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	14400	A^2s
			T_{vj} = 175 °C	10400	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 450 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.80	2.10	V
			T_{vj} = 125 °C		1.70		
			T_{vj} = 150 °C		1.65		
			T_{vj} = 175 °C		1.60		
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 600 V, I_F = 450 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 6900 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		377		A
			T_{vj} = 125 °C		480		
			T_{vj} = 150 °C		509		
			T_{vj} = 175 °C		538		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 600 V, I_F = 450 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 6900 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		39.2		µC
			T_{vj} = 125 °C		65.6		
			T_{vj} = 150 °C		76.4		
			T_{vj} = 175 °C		87.2		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 600 V, I_F = 450 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 6900 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		18		mJ
			T_{vj} = 125 °C		32.8		
			T_{vj} = 150 °C		37.4		
			T_{vj} = 175 °C		41.9		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				0.186	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

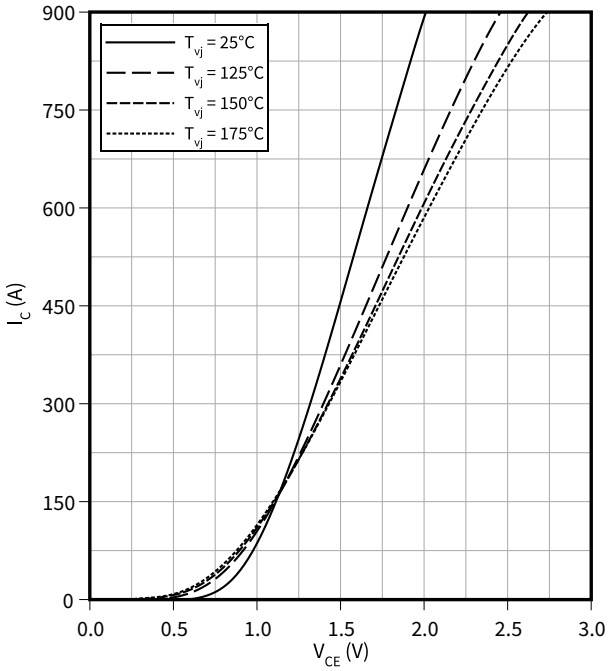
Anmerkung: $T_{vj\,op}$ > 150 °C is only allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications please refer to AN 2018-14.

4 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, T1 / T2

$I_C = f(V_{CE})$

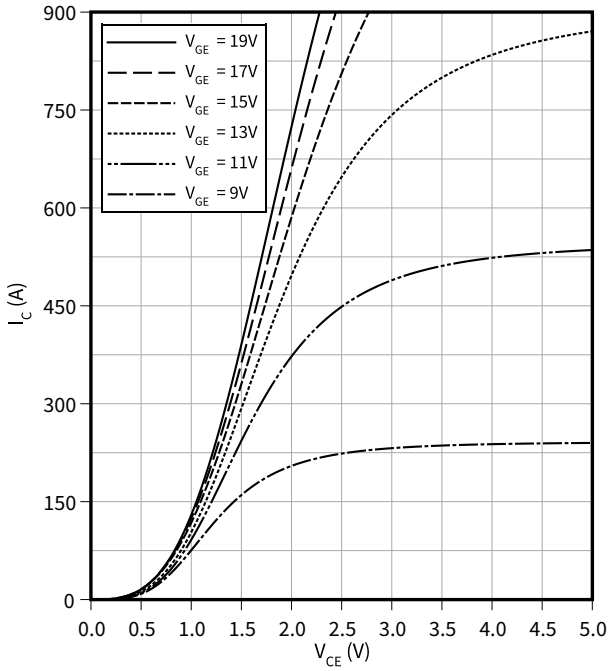
V_{GE} = 15 V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, T1 / T2

$I_C = f(V_{CE})$

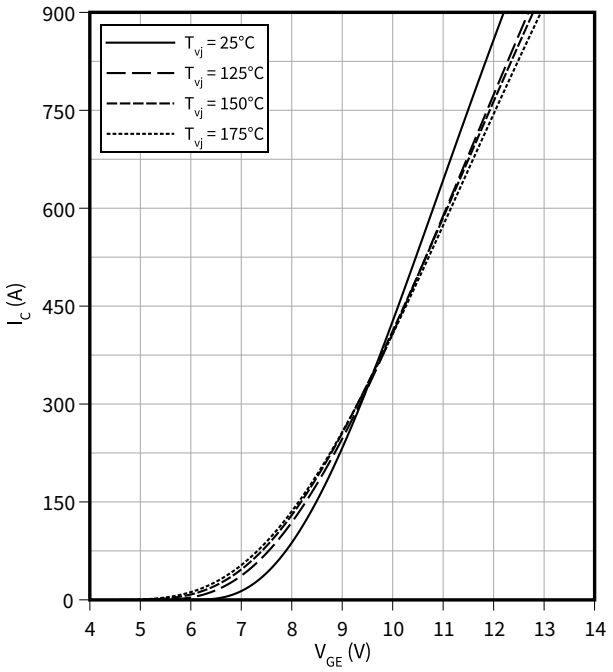
T_{vj} = 175 °C



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, T1 / T2

$I_C = f(V_{GE})$

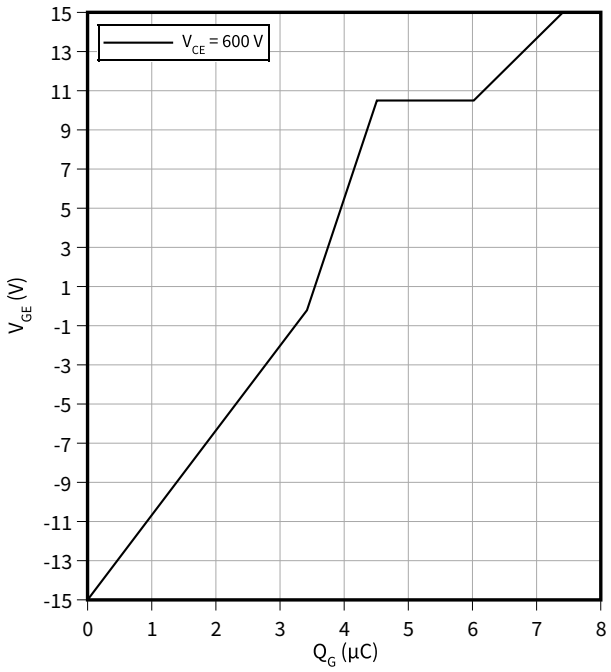
V_{CE} = 20 V



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, T1 / T2

$V_{GE} = f(Q_G)$

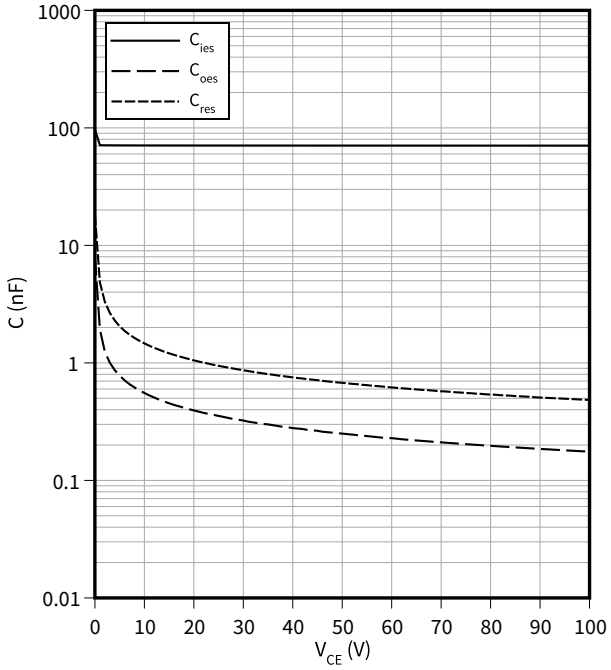
I_C = 450 A, T_{vj} = 25 °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, T1 / T2

$C = f(V_{CE})$

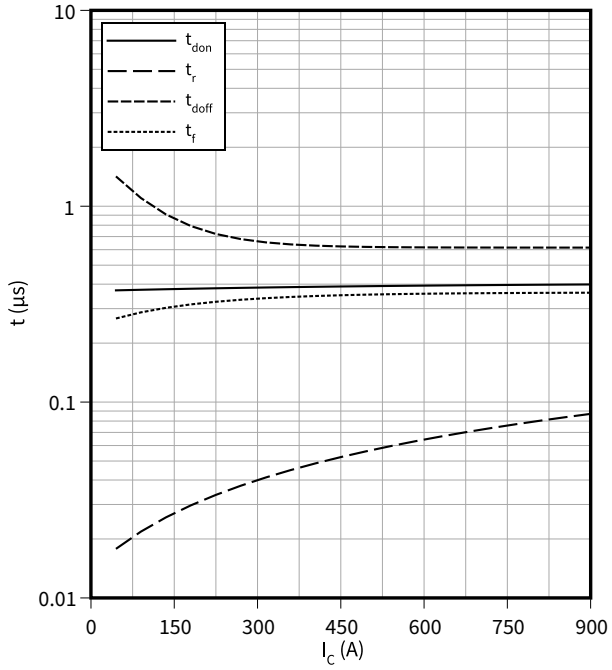
$f = 100\ kHz$, $V_{GE} = 0\ V$, $T_{vj} = 25\ °C$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T1 / T2

$t = f(I_C)$

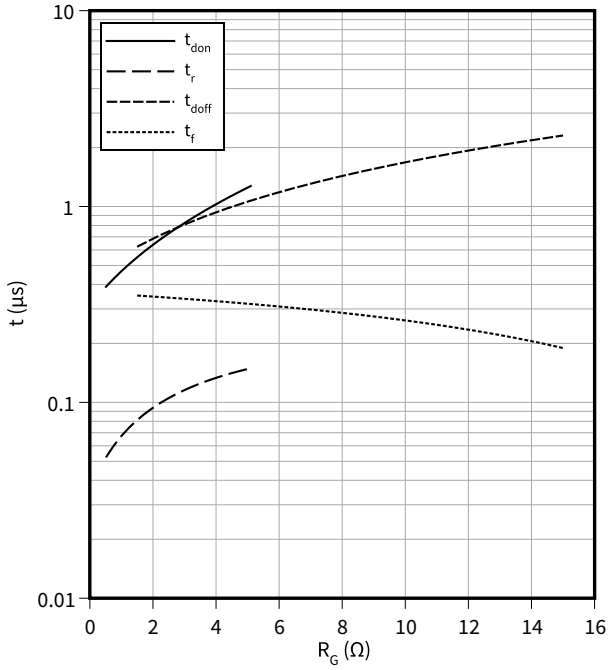
$R_{Goff} = 1.5\ \Omega$, $R_{Gon} = 0.51\ \Omega$, $V_{CC} = 600\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T1 / T2

$t = f(R_G)$

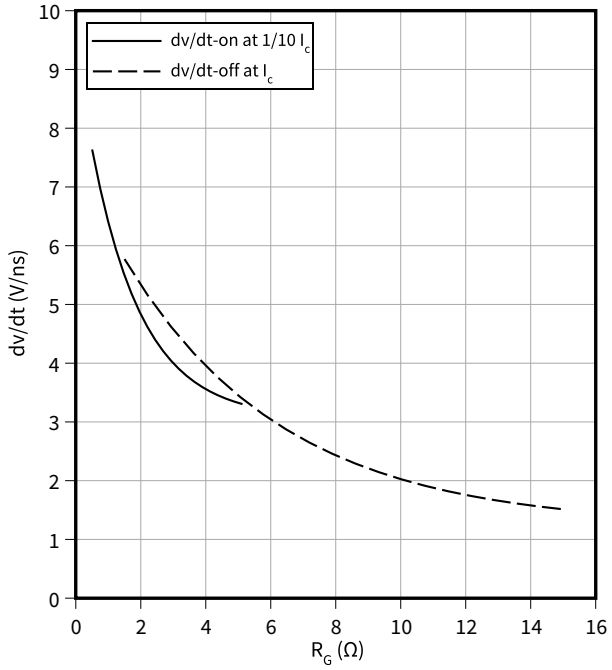
$I_C = 450\ A$, $V_{CC} = 600\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



Spannungssteilheit (typisch), IGBT, T1 / T2

$dv/dt = f(R_G)$

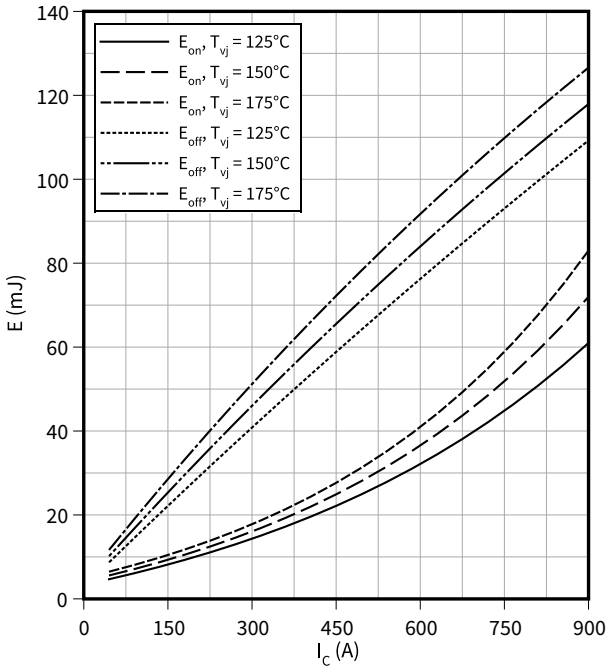
$I_C = 450\ A$, $V_{CC} = 600\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 25\ °C$



Schaltverluste (typisch), IGBT, T1 / T2

$E = f(I_C)$

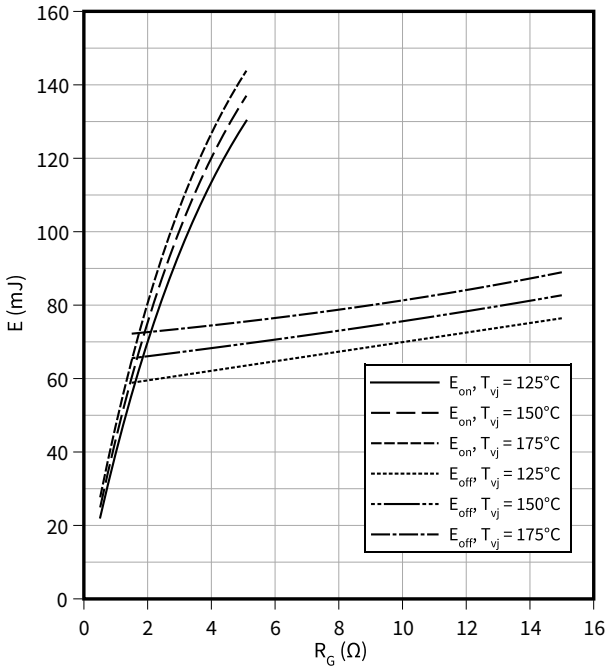
$R_{Goff} = 1.5\ \Omega$, $R_{Gon} = 0.51\ \Omega$, $V_{CC} = 600\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$



Schaltverluste (typisch), IGBT, T1 / T2

$E = f(R_G)$

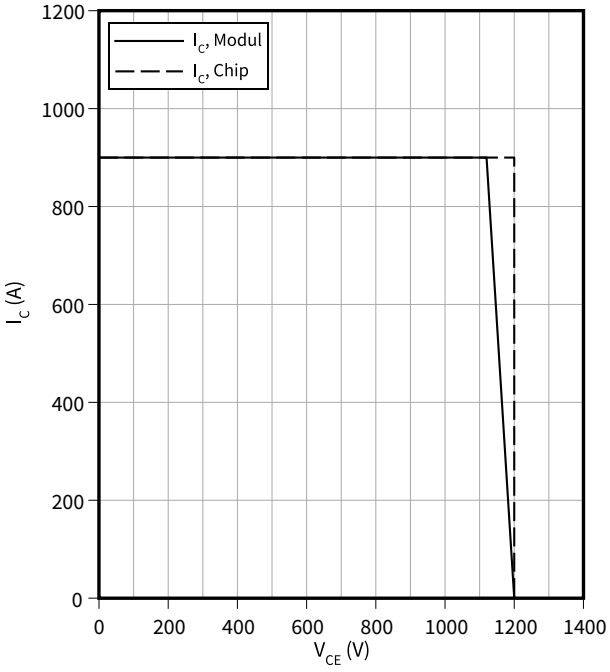
$I_C = 450\ A$, $V_{CC} = 600\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, T1 / T2

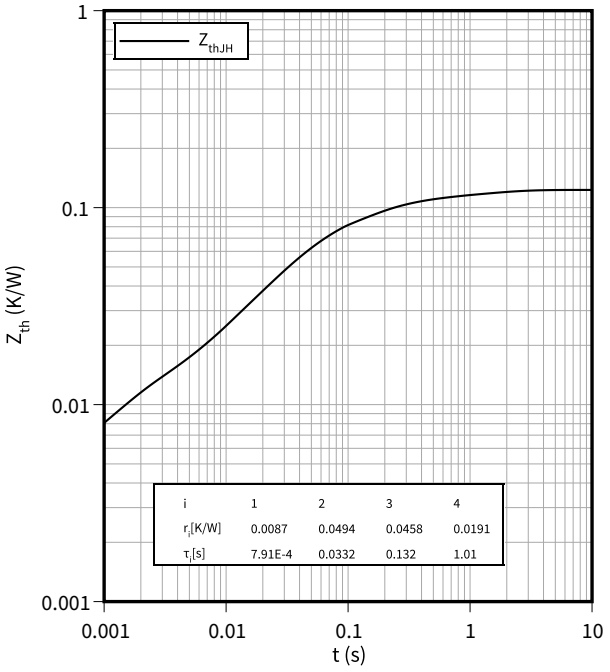
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 1.5\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



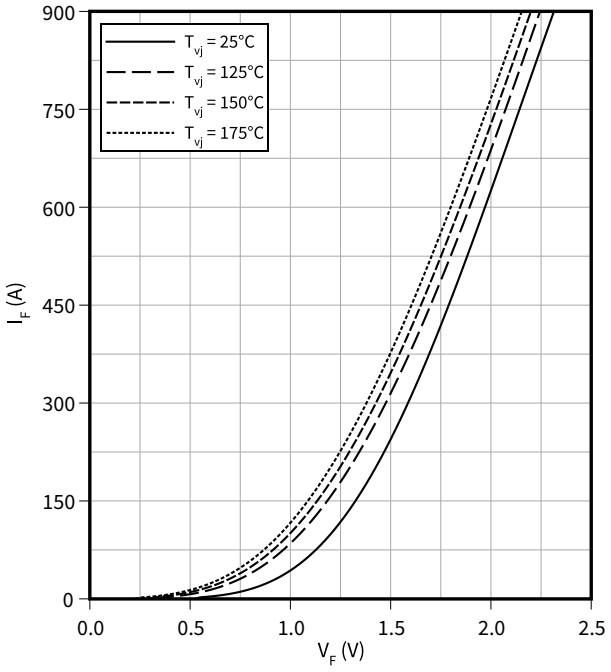
Transienter Wärmewiderstand, IGBT, T1 / T2

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, D1 / D2

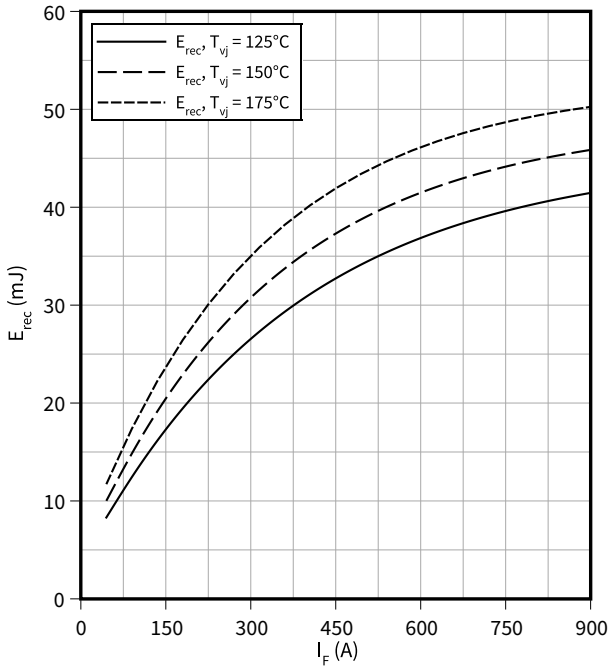
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, D1 / D2

$E_{rec} = f(I_F)$

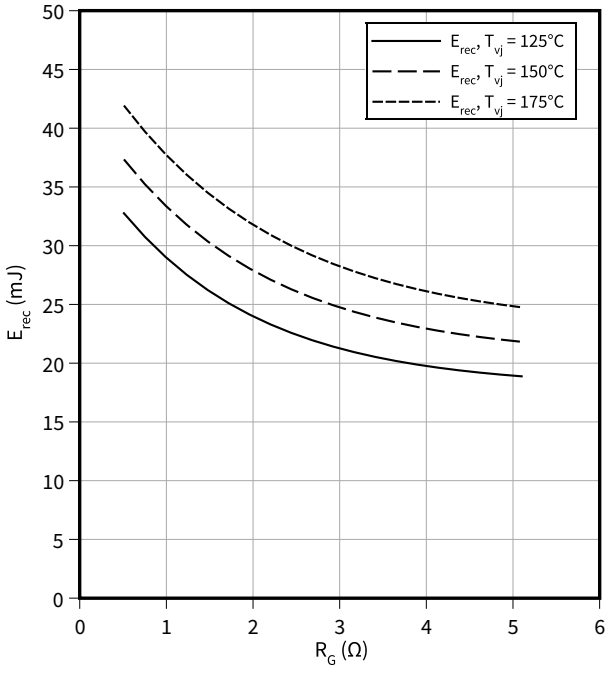
$R_{Gon} = 0.51\ \Omega$, $V_{CE} = 600\ V$



Schaltverluste (typisch), Diode, D1 / D2

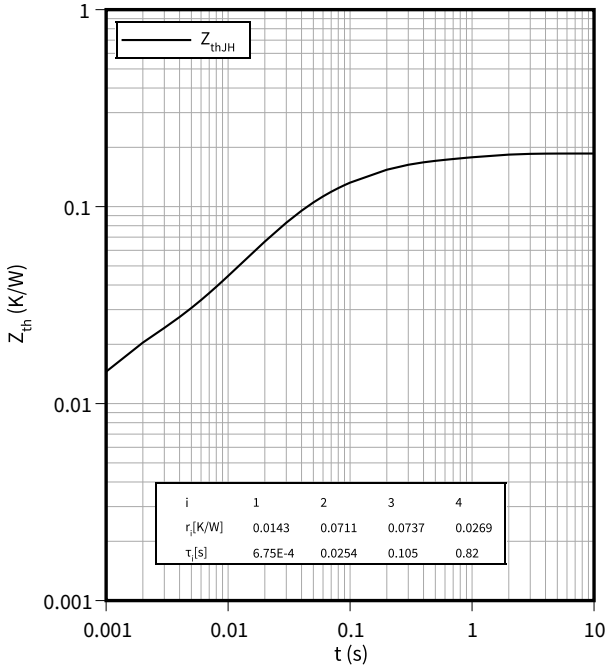
$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 600\ V$, $I_F = 450\ A$



Transienter Wärmewiderstand, Diode, D1 / D2

$Z_{th} = f(t)$



5 Schaltplan

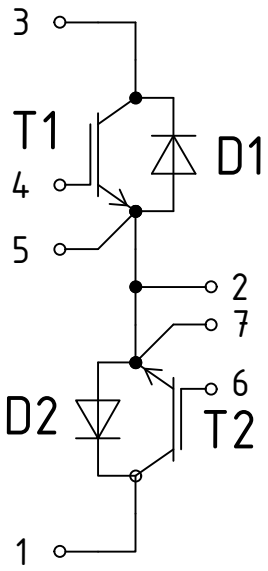


Abbildung 1

6 Gehäuseabmessungen

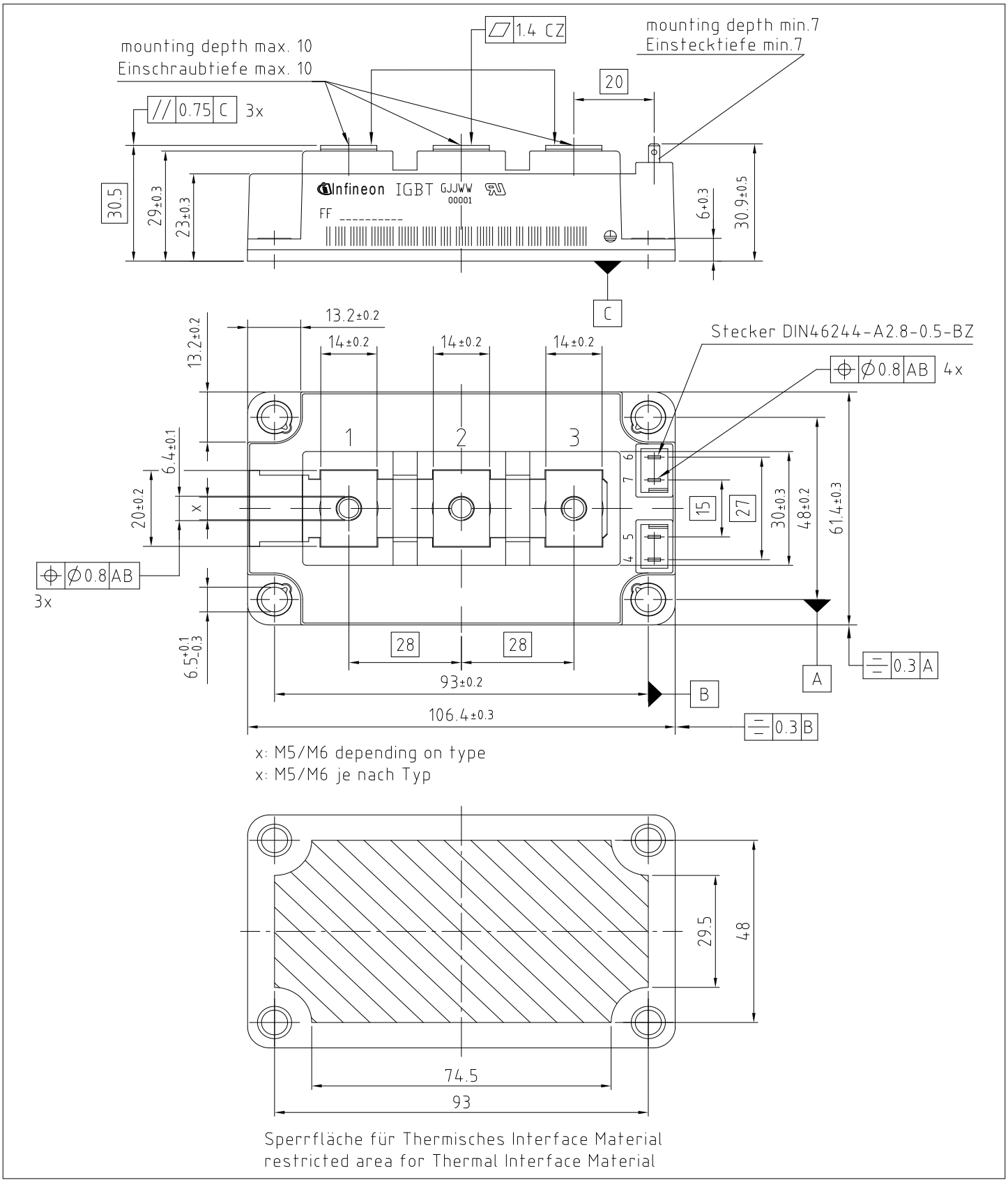


Abbildung 2

7 Modul-Label-Code

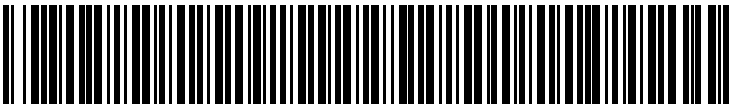
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 7154914284655054991530	 7154914284655054991530	

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
1.00	2023-07-17	Initial version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-07-17

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABH335-001

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.